

# FR30M

## 高效智能标签倒装绑定机

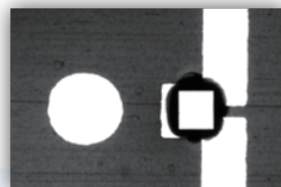
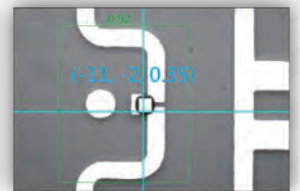
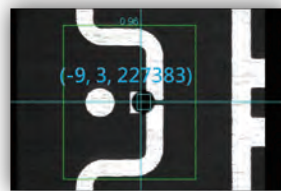
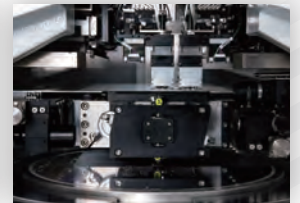


### 关于FR30M

- 固晶产能效率：30,000枚/小时
- 固晶精度：± 30um
- 角度精度：± 2°
- 热压头组数：40组
- 热压温度：常温 ~ 300°C ± 5°C
- 可生产40~340mm幅宽内产品
- 可多道生产、测试、分切、收料

### 产品特点

- 料带计算：(软件)计数料带长度
- 单喷胶系统、双复数取放固晶系统
- 实时监控喷胶状况，含胶量辨识功能
- 固晶前胶量辨识功能
- 实时监控固晶状况
- 热压头组可作局部程控
- QC拍照-人工检视
- 测试后胶量检测



# FR30M

## 高效智能标签倒装绑定机

项目	细部项目	规格	备注
主要规格	电源规格	单相, AC220V, 14A / 18A	
	正压气压规格	0.55Mpa	正压消耗量: 200L/min
	负压气压规格	-90kpa	负压消耗量: 50L/min
	机台尺寸 (mm · W x D x H)	12000 (L) x 1400 (D) x 2310 (H)	长度尺寸 · 含天线卷带入料处的作业空间 + 衬纸架放置所需的建议空间; 高度尺寸 · 含三色灯装置。
	机台总重量 (kg)	7800	设计时间的概估数值
	固晶产能效率	30,000ea/hour	视产品需求而定
	固晶精度 (um · X / Y direction)	±30	
	角度精度 (°)	±2.0	
卷带规格	卷带幅宽 (mm)	40 ~ 340 (Max.)	
	收放料带直径 (mm)	90 ~ 450	
	天线最小间距 (mm)	15.875 (Min.)	[ 双排以上天线卷带 ] X-Pitch ( 拉带方向 ): 15.875mm (Min.) Y-Pitch ( 排数方向 ): 35.00mm (Min.)
	天线卷带材质	PET、Paper	
芯片盘规格	芯片尺寸 (mm)	0.3x0.3 ~ 2.0x2.0	
	芯片盘尺寸 (inch)	8 / 12	
	芯片盘型式	STD Metal Frame	
卷带出料	卷带容许张力 (Kg)	0.1 ~ 1.0	
喷胶	适用于胶材类型	ACP	
	CCD 移动方式	Programmable control	
固晶	固晶力量 (g)	20 ~ 200	可编程
	CCD 移动方式	Programmable control	
芯片平台模块	扩张行程 (mm)	13 (Max.)	
	顶针座型式	单顶针	仅适用于较小的晶粒尺寸。
热压固化	热压力量 (g)	60 ~ 450	可编程
	固化温度 (°C)	Ambient to 300°C Max.	
	热压固化时间 (sec)	可依据胶材特性决定	此为制程参数条件 · 机台仅供可设定不同参数条件的功能需求。
	批次压合数量 (sets)	40 sets Max.	
	CCD 移动方式	Programmable control	
测试	芯片频率型式	HF / UHF	测试系统 或 装置 ( 包含测试软件、测试板、Reader 装置、接头端子、以及相关连接线材等 ) · 皆须由客户自行提供之。
卷带收料	收料轴	2	
	收料张力 (N)	3 ~ 10	
	分切刀具 (ea)	9 (Max.)	
	分切精度 (mm)	±0.50	

ALL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.